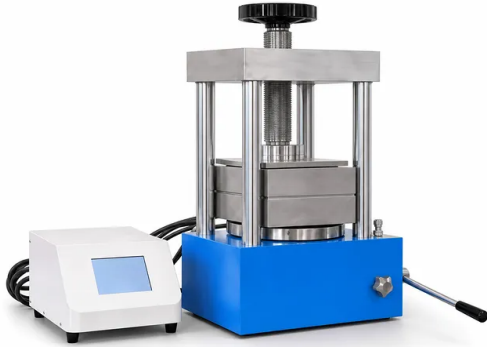


실험실 시료 준비용 24톤 200X200Mm 통합 가열 프레스

품목 번호: XP55



소개

24톤 클램핑력과 200x200mm 가열 플래튼을 갖춘 전문 통합 가열 프레스로, 배터리 연구, 재료 테스트 및 시료 준비에 이상적입니다. 300°C까지 정밀 온도 제어가 가능해 신뢰성 있고 일관된 결과를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
배터리 전극 및 전해질 프레스	리튬이온 및 차세대 배터리 셀용 음극/양극 분말의 고밀화 및 고체 전해질 펠릿 성형	균일한 밀도 분포로 핫스팟을 방지하고 펠릿 전체에서 일관된 이온 전도성을 보장합니다.
폴리머 필름 엠보싱 및 라미네이션	다층 폴리머 필름의 열 접합, 미세유체 칩 실링 및 랩온어칩 장치용 표면 텍스처링	정밀한 온도 및 압력 제어로 열 분해 없이 섬세한 나노구조를 보존합니다.
FTIR 및 XRF 펠릿 준비	적외선 분광법용 투명 KBr 펠릿 및 X선 형광 분석용 용융 비드 생산	공기 혼입과 두께 변화를 제거하여 재현 가능한 분광 베이스라인을 제공합니다.
복합 재료 개발	금속 기지 복합재, 세라믹 강화 폴리머 및 탄소 섬유 프리프레그의 핫 프레스 고밀화	제어된 열 및 압력 프로파일 하에서 섬유 함침을 극대화하고 보이드를 제거합니다.
제약 정제 파일럿 생산	제형 시험 및 안정성 연구를 위해 분말 혼합물을 정제로 소규모 압축	프레스 매개변수의 전체 데이터 로깅은 FDA/EMA 문서화 및 스케일업 연구를 지원합니다.
분말 야금 소결	최종 소결 전 고온에서 금속 및 세라믹 분말을 사전 압축	그런 밀도를 높이고 소결 수축을 줄여 최종 형상 정확도를 향상시킵니다.
반도체 웨이퍼 본딩	제어된 힘과 온도를 이용한 실리콘 웨이퍼 또는 칩온플렉스 조립체의 열 압축 본딩	보이드 없이 균일한 본딩 라인을 구현하며, 이는 마이크로전자기계 시스템(MEMS) 제조에 중요합니다.

매개변수	XP55
모델	XP55
프레스 용량	0 - 24톤
플래튼 작동 온도	상온 - 300 °C
가열 전력 (총)	1200 W (2 × 600 W)
플래튼 크기	200 × 200 mm
플래튼 냉각	통합 수순환
온도 제어	±2 °C 안정성의 듀얼 존 PID
디스플레이 및 제어	4.3인치 터치스크린, 프로그래밍 가능
전원 공급	220 V, 50 Hz, 단상
전체 크기 (가로 × 세로 × 높이)	950 × 260 × 525 mm

매개변수	XP55
순중량	180 kg